(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2004 年9 月2 日 (02.09.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/074344 A1

(51) 国際特許分類[7]: C08G 59/62, C08L 63/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/001569

(22) 国際出願日: 2004 年2 月13 日 (13.02.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-039620 2003 年2 月18 日 (18.02.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川二丁目5番8号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西川 敦准 (NISHIKAWA, Atsunori) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 浅村 皓, 外(ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒1000004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル331 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) **Title:** EPOXY RESIN COMPOSITION AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: エポキシ樹脂組成物及び半導体装置

(57) **Abstract:** An epoxy resin composition which is excellent in flowability, adhesion to substrates, flame retardancy, and soldering crack resistance without containing any brominated organic compound or antimony compound. The epoxy resin composition, which is for semiconductor encapsulation, is characterized by comprising as essential ingredients a phenol aralkyl type epoxy resin having a biphenyl skeleton, a phenol aralkyl resin having a biphenyl skeleton, a curing accelerator, an inorganic filler, a specific silane coupling agent having a secondary amine, and a specific silane coupling agent having a mercapto group.

(57) 要約: 本発明の目的は、臭素含有有機化合物、アンチモン化合物を使用せずに、流動性、基板との密着性、難燃性、及び耐半田クラック性に優れたエポキシ樹脂組成物を提供することである。本発明に従えば、ビフェニル骨格を有するフェノールアラルキル型エポキシ樹脂、ビフェニル骨格を有するフェノールアラルキル樹脂、硬化促進剤、無機充填材、２級アミンを有する特定のシランカップリング剤、及びメルカプト基を有する特定のシランカップリング剤を必須成分とすることを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物が提供される。

WO 2004/074344 A1